



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110429001A
2012 年 3 月 26 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

TI-Philippines製造 PBGAパッケージ 一部製品 代替Substrate部材追加取消のご案内

(初版 PCN20110429001 2011 年 4 月 29 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更取消についての連絡になります。本変更は実施されません。詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、30 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。お客様の受領連絡は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -		
変更内容	初版連絡の下記変更内容について変更取消の連絡になります。 TI-Philippines 製造 PBGA パッケージ 一部製品 代替 Substrate 部材追加 現行 : 認定 Substrate 変更後: 認定 Substrate, Hitachi 社製 Substrate			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	—			
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容: 今回のお知らせは、2011年4月29日発行 初版 PCN20110429001にて連絡しました下記変更について、変更取消の連絡になります。現行の部材供給業者復旧のため、本変更実施を取り消します。今後、本変更部材供給業者も含め新規部材供給業者を使用する際には、新規PCNにて、信頼性試験計画及びサンプル提供と共に別途お知らせいたします。

弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト)/ASP-MCU(マイクロコントローラ) TI-Philippines(フィリピン)サイト製造 PBGAパッケージ 一部製品について、震災状況下での供給能力確保の為、代替Substrate部材追加の連絡になります。一部部材の供給制限のため、認定試験終了次第、本代替部材の追加変更は直ちに実施予定です。認定終了前のいかなる製品出荷についても、事前顧客承認が必要になります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

Substrate 部材

現行

認定 Substrate

変更後

 認定 Substrate
 Hitachi 社製 Substrate

理由: 供給能力確保の為

製品表示

この変更による製品捺印、出荷ラベルの変更はありません。部材識別については、弊社標準のロット追跡及び製造手順によりトレーサビリティは確保されます。

対象製品リスト

対象製品名				
AM1707BZKB3	D790E002BZDH300	DRA446A1ZEDQ1M	TMS320C28346ZFET	TMS320C6747BZKB3
AM3505AZERQ5	D810K003BZKB300	DRA457A1ZEQQ1M	TMS320C6421ZDU4	TMS320C6747BZKBA3
AM3517AZER	D810K003BZKBT300	DRA457B1ZEQQ1M	TMS320C6424ZDU4	TMS320C6747BZKBT3
AM3517AZERA	D810K003BZKBT400	DRA526AZERRQ1	TMS320C6424ZDU6	TMS320DM6435ZDU5
D710E001BZDH275	D810K013BZKB400	DRH407B1ZDUQ1	TMS320C6424ZDUQ6	TMS320DM6437ZDU6
D710E001BZDH300	D81YK113BZKB300	DRH416B1ZDUQ1	TMS320C6727BGDH300	TMS320DM6437ZDU7
D710E001BZDHA275	D81YK113BZKB400	DRH443B1ZDUQ1	TMS320C6727BZDH250	TMSDC6727BGDHA250
D710E002BZDHA275	D830K003BZKB300	DR1416B1ZDUQ1	TMS320C6727BZDH275	TMSDC6727BZDHA250
D790E001BZDH275	D830K013BZKB300Z	OMAPL137BZKB3	TMS320C6727BZDH300	TNETC4710ZDW
D790E001BZDH300	DRA407B1ZDUQ1	OMAPL137BZKBA3	TMS320C6727BZDH350	TNETV1055NNZDW
D790E001BZDH300Z	DRA416B1ZDUQ1	PDR1459A1ZEQQ1	TMS320C6727ZDH300	TVP9001ZDS

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 8 月 15 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qualification Device:	F771558ZXZ/ DRA457BIZEQRQ1	Substrate:	Hitachi Substrate	
Package:	PBGA	Site(s):	PHI	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Material Property Comparison	Specification Review		per spec	
Preconditioning	JEDEC L-4/260C		539	
High Temperature Storage Life	150C, 600hrs Note (1)		45	
Temperature Cycle	-55C/125C, 1000cyc		231	
Temperature Humidity Bias	85C/85%RH, 600hrs Note(1)		77	
UnBiased HAST	130C/85%RH, 96hrs		231	
Note (1): Qualification Device release at 600hrs, other device Qual by Similarity/Bridge at 1000hrs				